

中国大模型立于世界舞台中心

本报记者 宋婧

3月3日,被誉为全球通信与科技领域“风向标”的世界移动通信大会(MWC25)在西班牙巴塞罗那正式拉开序幕。本届MWC以“Converge、Connect、Create”(融合、连接、创造)为主题,聚焦5G-Advanced(5G-A)、人工智能、物联网、量子计算等前沿技术,吸引全球约2700家企业参展,其中中国企业超过300家。

近来,随着大模型引爆全球市场,在MWC讨论AI的声音已经逐渐盖过了传统的移动通信行业话题。“我们在移动产业发展中看到的颠覆性力量在人工智能(AI)时代再次出现。”MWC主办方、全球移动通信系统协会(GSMA)总干事马茨·格兰雷德说道。

AI与通信的深度融合已成为行业发展新潮流,而随着DeepSeek搅动全球AI风云,强势扭转海外市场对中国AI技术的刻板认知,越来越多的中国大模型产品开始站在世界舞台的聚光灯下。本届MWC上,众多中国展商纷纷拿出看家本领同台竞技,吸引了多方关注。

中国电信特别设置了“星辰·基础大模型”和“星辰·行业大模型”两大展区,展示其自主研发的覆盖语义、语音、视觉、多模态的“星辰大模型”产品矩阵,包含工业节能控制大模型、应急监测预警视觉大模型、汽车行业智能座舱大模型等多个行业大模型和行业智能体,以及星辰绘影、AI手机等基础大模型的前沿进展,为观众带来身临其境的大模型创新体验。

中国移动自研的九天基础大模型,涵盖语言、视觉、语音等多种类型大模型,也吸引了不少观众驻足观看。结合行业形成的九天·客服大模型,让用户拥有24小时在线的“专属管家”,而基于此推出的智能助理“灵犀”,可实现个性化伴随式服务、意图精准识别、多轮交互、拟人化功能,打造全新交互体验。此外,中国移动还展示了体系化人工智能技术、九天智慧网络孪生仿真平台等应用成果,全方位赋能政务、



图为中国移动总经理何飏作主旨演讲

社会综治、医疗、文体等行业的数字化转型。

中国联通则在本届MWC上正式推出首款自研AI文创终端,深度融合品牌IP与生成式人工智能的终端产品——“通通AI”智慧终端,标志着中国联通在“算网数智”战略布局中迈出里程碑式一步。该产品以中国联通吉祥物“通通”为原型设计,搭载中国联通自主研发的元景大模型(UniAI),集娱乐、早教、智能助手等多种功能于一体,满足了不同用户群体在不同场景下的需求。

中兴通讯推出的数字星云3.0内置星云大模型,整合大模型训练、推理、应用开发全流程工具,帮助行业客户多快好省地使用AI。在南京滨江工厂,通过星云工业大模型实现工艺文件生成提速10倍、质检人力成本降低70%。同时对外赋能,在工业、交通、能源等领域打造创新应用实现AI价值变现。

华为通信大模型落地MWC,并发布了最新研发的AI-Centric Network(以AI为中心网络解决方

案),旨在通过AI技术提升网络连接效率与智能化运维能力,应对智能终端普及带来的网络需求变化。该方案包含三部分:全域网络连接支持差异化业务保障,AI驱动的预测式运维系统,以及面向个人、企业和社会场景的智能协同能力。

值得一提的是,根据MWC官方发布的信息,阿里云、腾讯云等中国企业首次参展。阿里云携数十家AI软硬件企业在MWC展台亮相,展示了以通义系列大模型为底座的AI产品,比如与大象机器人合作研发,预计下半年推出搭载大模型的AI陪伴玩具。腾讯云则是首次以独立展商身份亮相,并推出Super-APP(超级应用)解决方案。该方案整合了微信生态服务13亿名用户的大量经验和技能积累,能为企业构建自己的“SuperAPP”提供从开发到运营的全生命周期支持。

根据权威调研机构麦肯锡的预测,在移动通信行业,未来15年至20年,AI对移动网络运营商的市场影响可能高达6800亿美元。GSMA首席技术官亚历克斯·辛克莱

表示,虽然业界仍处于AI发展的早期阶段,但这项技术已经展现出变革不同经济领域的潜力。

“高品质低成本开源大模型的发展,必将催生多样化应用创新,推动智能世界加速到来。”华为董事、ICTBG CEO杨超斌表示,“可以预见,AI将从三个维度重构社会图景:赋能个人实现差异化业务体验、驱动组织向智能化协作演进、助推社会向AI普惠化升级。应用场景裂变和技术的演进,为ICT产业带来前所未有的发展机遇,也对网络基础设施提出新的要求,需要在带宽、时延、覆盖、运维运营等维度实现全方位突破。”

中国移动总经理何飏指出,AI大模型已快速逼近通用人工智能奇点,“AI+”时代正加速到来。具体体现在四个方面:一是“AI+”加速信息消费升级,重塑数智生活方式;二是“AI+”加速产业体系变革,重塑生产运营模式;三是“AI+”加速智能决策创新,重塑社会治理形态;四是“AI+”加速新兴技术突破,重塑科技创新范式。

“AI汽车”行则将至

本报记者 张维佳

车机互联、智能驾驶、智能座舱、“人车家全生态”……在今年的世界移动通信大会(MWC25)上,汽车科技备受瞩目。随着汽车AI化、消费电子化趋势的不断加深,人工智能、5G等前沿技术为汽车的智能化发展带来了全新的机遇和变革。

中国移动在MWC25上重点展示了其人车家协同技术以及车路云技术。其中,人车家协同技术可实现车内对家中智能设备的控制,如提前开启家中空调、查看家中监控摄像头等操作,操作响应时间平均不超过1秒。而车路云技术实现了汽车与道路、云端的无缝连接。汽车可实时获取道路信息,如前方路段交通拥堵情况、道路施工信息等,信息更新速度较传统方式提高50%以上。同时,云端能够对汽车进行远程监控与管理,一旦汽车出现故障,云端可即时接收报警信息并提供解决方案,全方位保障汽车的智能化运行。

展会现场,中国移动还展示了其打造的智能座舱。该座舱依托九天大模型,显著提升了交互能力,能够学习和理解驾驶员的习惯与需求,进而提供个性化服务。例如,在出行路线规划方面,依据驾驶员平时的驾驶时间、路况偏好等因素,规划出的最优路线,精准度较普通导航提高20%左右。

华为云商专车带来了其在矿山场景中无人驾驶作业的最新成果。在云端,融合了多种传感器的感知能力,可以在大风扬尘40m能见度的极端天气、夜间环境下持续作业;云端能够及时提供车队调度管理系统、自动驾驶监管服务及动态业务

地图云服务,最终实现7×24小时常态化无人作业,整体提升作业效率高达135%。

小米SU7 Ultra亮相MWC25,这是小米首次在海外市场展示小米SU7 Ultra。作为小米旗下的高端纯电车型,SU7 Ultra于2月27日发布。该车搭载了小米超级三电机系统,最大马力高达1548ps,零百加速仅需1.98秒,实测最高时速超过359km/h。小米集团合伙人、总裁卢伟冰在展会上表示,希望2027年小米汽车“正式出海”。

美格智能在MWC25上宣布,其全新一代5G智能座舱模组正式获得国内某头部大厂前装智能座舱平台型大周期项目定点。据了解,该模组基于SoC芯片开发,采用

4nm制程;通信能力方面,支持集成式高速5G通信、Wi-Fi 7及BT 5.3;计算能力方面,内置8核CPU处理器,支持4K 60Hz超高清显示和8K高清视频解码;AI能力方面,综合AI算力接近50TOPS,支持INT4、INT8、INT16、FP16等多种混合精度计算,支持ONNX、PyTorch、TensorFlow、CAFFE、TensorFlow Lite等主流AI模型框架。

这些性能可以提升智能座舱端侧计算能力,不仅能够为用户提供智能语音交互、沉浸式座舱渲染、超高清多媒体等体验,同时支持接入和端侧部署DeepSeek、Qwen等大模型,并可凭借AI能力,支撑舱泊一体、舱驾一体等跨域融合功能。

星纪魅族带来其智能座舱操作

系统——Flyme Auto。据悉,Flyme Auto可通过改变智能汽车技术架构,让手机成为汽车的一部分,让升级手机和升级车机配置划等号,从而提升智能座舱使用体验,成为超越传统汽车五个域(动力域、底盘域、车身域、座舱域、自动驾驶域)的第六域。目前,Flyme Auto已接入吉利、领克、银河等多个品牌的22款车型,是搭载上市车型最多、增长速度最快的智能座舱操作系统之一。

高通在MWC25上推出了多款全新4G物联网调制解调器,包括行业首款支持集成SIM(iSIM)功能的调制解调器,可覆盖各类网络和物联网终端,包括智能仪表、智慧城市、泊车、可穿戴设备等。

3月3日,世界移动通信大会(MWC25)在西班牙巴塞罗那开幕。自去年6月R-18标准冻结后,经过大半年的技术储备与产业发展,在今天的展会上,各家通信领域头部企业纷纷以5G-A为“主旋律”,展出了自家移动通信网络方面的新产品、新技术,“5G-A×AI”也成为了本届MWC最受关注的主题之一。

可以看到,5G-A技术日渐成熟,产业关注度与日俱增,5G-A真正落地赋能生产生活已经近在眼前。

5G-A扑面而来

本报记者 张琪玮

展会上,华为公布了AI-Centric 5.5G系列解决方案。华为表示,该方案“业界首次”实现了5G-A与AI技术的深度融合,利用更低时延、更高带宽和更稳定的5G-A网络,让AI的软硬件体验得到显著升级,并且提供高效便捷的部署解决方案。

据了解,本次华为AI-Centric 5.5G首批推出的GiGaGear、Green-Pulse、GainLeap实现用户体验提升,在无线网络中全栈引入智能化能力,通过数字孪生站点和基于无线智能体的数字人团队,构建工作流智能体协同体系,实现网络资源的协同调度和多样化应用的敏捷部署,将能够更好地满足移动AI时代的差异化需求。

展会期间,中国移动携手荷兰皇家电信(KPN)、韩国电信(KT)、韩国LG Uplus、韩国SK电讯(SK Telecom)、英特尔(Intel)以及国内设备和终端厂家等全球16家合作伙伴共同发布了《智能体通信网络(ACN)白皮书》,并展示了业界首套ACN原型样机。

据了解,该样机实现了智能体通信的数字身份管理、可控灵活组网和多智能体协同等网络能力。中国移动表示,“智能体通信”需要为不同形态、不同能力、不同用户的智能体提供全球互联和安全可控的信息交互服务,这需要设计新的组网和交互模式,颠覆已有流量模式,催生全新的网络服务。本次展会上系列成果的发布,有望为6G发展提供新的助力。

在与展会同期举办的共建共享网络5G-A创新成果发布会上,中国联通与中国电信联合GSMA,共同发布了《共享网络智慧共治白皮书》及共享网络5G-A演进创新成果。

据了解,本次发布的共享网络5G-A创新成果就涵盖了载波聚合、RedCap、AI等方面,旨在通过5G-A网络技术和AI应用深化,不断催生新动能、新场景、新业态。记者了解到,当前,中国联通、中国电信积极推进共享网络向5G-A升级演进,加速推进载波聚合演进和规模应用,实现了下行万兆、上行千兆的超高速率;聚焦端网协同创新,加速产业成熟,实现了全球首个全频段、全制式、全场景、全产业的5G RedCap商用;创新确定性网络关键技术,构筑了低时延、高可靠、低抖动、高精度的5G-A确定性网络,在工业制造领域实现了时延4ms和99.999%的可靠传输。截至目前,双方已在超300个城市部署载波聚合能力,在150个城市升级RedCap轻量级物联,在10个城市试验低空通信网络。

爱立信围绕其主推的“高性能可编程网络”展示了近期发布的最新网络软硬件产品与解决方案。产品方面,爱立信展出其超薄设计的宽带TDD Massive MIMO无线产品Air 3266,及双频FDD Massive MIMO无线产品AIR 3285。

据了解,Air 3266搭载了最新的爱立信硅芯科技(Ericsson Silicon),输出功率为400W,实现能耗降低30%,隐含碳足迹降低50%;AIR 3285重量仅30公斤,为同类产品中最轻,上行链路容量提升高达4倍。

此外,爱立信还特别为5G-A、6G技术设计了展台:在5G-A展区,爱立信搭建玻璃投影隧道,让观众沉浸式体验5G-A各方面软件的增强功能,感受5G-A技术带来的全新体验;在6G展区,通过“空间感知立方体”,爱立信演示了空间感知技术,展出其与三方终端互操作的厘米波6G测试床以及光子集成Radio,并展出了首款6G太赫兹原

型机。据了解,该原型机可覆盖100-300GHz频段。

中兴通讯展示了其多款搭载AI、5G-A、Wi-Fi 7技术的新品终端,并一举摘下多个“全球首款”:例如,其推出全球首款AI驱动的5G-Advanced旗舰级FWA设备——中兴G5 Ultra,峰值速度可达19Gbps;其带来的全球首款30dBi Wi-Fi 7毫米波FWA中兴G5 Max Wi-Fi则搭载30dBi超高增益天线,峰值速率高达10Gbps,稳定信号下覆盖距离高达6km;此外,其展出的“全球最快”Wi-Fi 7 5G随身Wi-Fi——中兴U60 Pro,支持双频Wi-Fi 7,为用户带来高速网络连接及多用途、易用的产品体验。同时,中兴还展示了ATG民航通信、NTN卫星通信技术,实现空地一体泛在连接,以通感一体赋能低空经济、水域管理商业落地。

在诺基亚展台,其围绕“any-RAN, AI for RAN, 极致能效、无线创新、引领未来”五大主题,推出20款创新科技和解决方案,涵盖云化的网络架构、AI赋能的无线网络、可持续发展的创新方案及领先的无线设备。其中,其在无线技术创新领域的新技术、新产品格外受到业界关注,推出了新一代IPAA+有源+无源天线解决方案、Habrok双频Massive MIMO无线设备、Kolibri一体化小基站等一系列产品。同时,聚焦6G,诺基亚表示,其7GHz频段研究表现出了与3.5GHz相当的数据速率,该技术为5G站点平滑升级6G提供了可行路径。

联发科则带来了其最新发布的5G-A调制解调器,5G NR-NTN、6G混合计算技术以及生成式AI等多方面的技术创新。

据了解,其M90 5G-Advanced调制解调器传输速度高达12Gbps,符合3GPP Release 17以及Release 18标准规格,同时支持FR1及FR2频谱和全新智能天线技术,与前代相比平均功耗可降低18%;其新一代5G-A NTN通信技术可以通过Ku频段NR-NTN技术赋能5G-A设备宽带通信,实现全球范围的无基站5G服务。同时,联发科还展出了其通信运算系统融合智能技术等一系列新技术,实现通信与计算的深度融合。此外,其下一代无线通信产品的设计预览方案和新一代6G频谱的子频全双工技术则有望在5G-A、6G等领域落地应用。

高通推出了跃龙第四代固定无线接入平台至尊版,这是全球首款5G Advanced FWA平台。该平台搭载高通X85 5G调制解调器及射频,下行速率高达12.5Gbps,提供Sub-6GHz和毫米波连接以支持无缝流传输、下载和游戏。同时,高通在展会期间表示,2025年将专注于6G无线技术研发并支持FR3频段,“希望将6G打造为集在多个层面和设备内部集成人工智能的全新网络”。

紫光展锐推出其新款5G SoC—T8300芯片。该芯片全面支持最新3GPP R17标准,并首次融合了5G NR NTN卫星通信、5G MBS广播等功能,极大地拓展了5G应用场景。据了解,该芯片采用了6nm工艺,八核CPU架构,由2个主频为2.2GHz的Arm Cortex-A78大核和6个主频为2.0GHz的Arm Cortex-A55组成,A78主频相比上一代产品能效提升了28%;同时,支持5G NR单载波聚合技术,可实现100MHz的频谱带宽聚合,并支持2G到5G多模全网通。紫光展锐表示,全场景覆盖增强技术和智能网络切换功能的加入,使得用户在不同场景下都能享受到稳定、高效、低功耗的通信体验。记者获悉,展锐5G芯片已在全球范围内规模出货,搭载该芯片的5G手机已在全球76个国家和地区出货。



图为小米SU7 Ultra